

证券代码：688126

证券简称：沪硅产业

公告编号：2024-004

## 上海硅产业集团股份有限公司

### 2023年年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、本期业绩预告情况

##### （一）业绩预告期间

2023年1月1日至2023年12月31日。

##### （二）业绩预告情况

（1）经财务部门初步测算，预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润约为16,800.00万元到20,100.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少15,703.17万元到12,403.17万元，同比下降48.31%到38.16%。

（2）归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润将出现亏损，为-18,000.00万元到-14,400.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少29,524.88万元到25,924.88万元。

（3）本次业绩预告数据系公司初步测算，未经注册会计师审计。

#### 二、上年同期业绩情况

2022年年度归属于母公司所有者的净利润：32,503.17万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：11,524.88万元。

#### 三、本期业绩变化的主要原因

报告期内，公司经营业绩较2022年有较大幅度的下降，主要是受市场影响和公司扩产项目持续投入的影响。

##### 1. 市场影响

2023年全球经济增速延续2022年的放缓趋势，且地缘政治紧张局势加

剧将带来新的挑战。受此大环境的影响，半导体行业仍处于周期性调整阶段，全球晶圆出货量明显下降。据 SEMI 统计，受终端市场持续疲软、半导体产业高库存和宏观经济状况影响，2023 年全球半导体硅片出货量相比 2022 年下降 14.3%。报告期内，公司半导体硅片收入受整体市场影响同比下降约 12%，导致经营利润相应减少。

## 2. 扩产项目影响

2023 年公司多个扩产项目，包括集成电路用 300mm 高端硅片扩产项目、300mm 高端硅基材料研发中试项目和 200mm 半导体特色硅片扩产项目均有序推进，其中集成电路用 300mm 高端硅片扩产项目到 2023 年底已释放 15 万片/月的新产能，合计产能达到 45 万片/月。扩产项目在实施过程中会产生一定前期费用同时增加较大的固定成本，对公司报告期内的经营业绩产生较大影响。

## 四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算数据，尚未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

## 五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2023 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2024 年 1 月 27 日